

## MCX300 シリーズ鉛フリー化のご案内

いつも MCX300 シリーズ IC をご愛顧いただきまして、ありがとうございます。

このたび半導体メーカーによる鉛フリー化推進に伴い、下記該当製品に付きまして、鉛フリー化対応品に切り替えを進めて参りますので、宜しくお願ひいたします。

今後とも変わらぬご愛顧を賜りますよう、宜しくお願ひ申し上げます。

製品名	パッケージ	鉛フリー化の内容	鉛フリー化実施時期
MCX305	QFP80P1420-0.8	パッケージ耐熱温度が、リフローでの鉛フリー実装対応となります。(別紙 A 参照) 鉛は従来品においても含まれておりません。	2004年9月より、従来品の在庫が終了し次第、鉛フリー対応品に切り替えさせて頂きます。
MCX302	QFP100P1420-0.65		
MCX304			
MCX312			

### 鉛フリー対応品の実装条件

鉛フリー対応品を鉛フリー半田ペーストでリフロー実装する場合には、従来の温度プロファイルと異なります。別紙 A 参照。

### 従来通りの実装も可能

上表 IC のリード端子外装処理(メッキ)素材は、従来より Ni/Pd/Au(ニッケル/パラジウム/金)で、鉛を含んでおりません。鉛フリー対応品についてもリード端子外装処理は変更ありませんので、従来の Sn-Pb 半田ペーストで実装する場合には従来通りの温度条件での実装が可能です。

### 出荷の形態

2004年9月以降は、しばらくの期間(弊社の従来品の在庫が終了するまでの期間)、通常の製品名でご注文されますと従来品または鉛フリー対応品のいずれかが納品されることとなります。鉛フリー対応品が納品される場合には「鉛フリー対応品」と明示されています。また、従来品と鉛フリー対応品が同一購入品内で混在することはありません。

### 鉛フリー対応品指定のご注文

2004年9月以降、鉛フリー対応品を指定してご購入を希望されるお客様は、製品型名の末尾に”G”を付けてご注文ください。例:MCX312G

- 以上 -

## 資料A 鉛フリー対応品の推奨実装条件

### 1 はんだごてによる標準実装条件

本ICのはんだごてによる標準実装条件は、以下の通りと致しております。

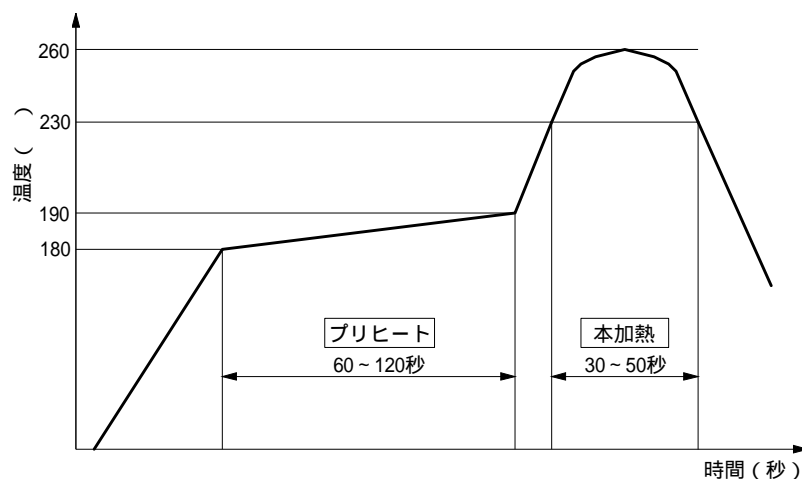
- (1) 実装方法：はんだごて（リード部の加熱のみ）
- (2) 実装条件：(a)350 、3 秒以内  
                  : (b)260 、10 秒以内

### 2 リフローによる標準実装条件

本ICのリフローによる標準実装条件は、以下の通りと致しております。

- (1) 実装方法：                  (a)温風リフロー（遠中赤外線リフロー併用方法を含む）  
                  :                  (b)遠中赤外線リフロー
- (2) プリヒート条件：          180～190 、60～120 秒
- (3) リフロー条件：             (a)最高260  
                                  (b)230 以上、30～50 秒以内
- (4) リフロー回数：             許容保管期間内において2 回まで

なお、実装条件における温度につきましては、パッケージ表面温度を基準と致しております。温度プロファイルは耐熱温度の上限を示しており、下図プロファイルの範囲内で実装願います。



標準リフロー耐熱温度プロファイル